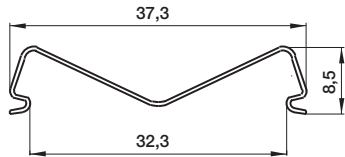
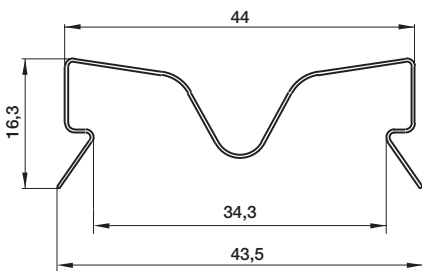


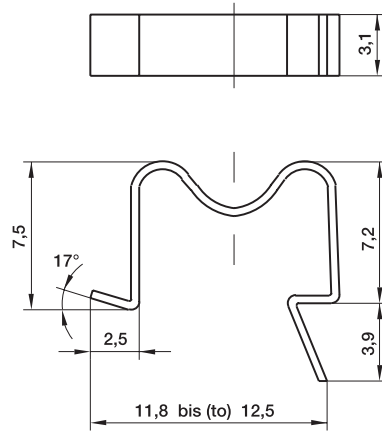
Edelstahl Montageclips | Mounting clips (stainless steel) | Clips des montage (inox)



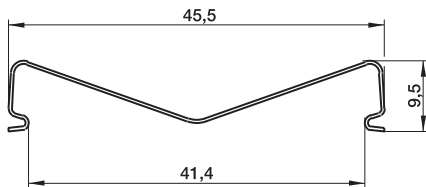
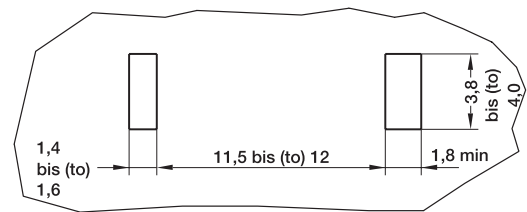
KC-194



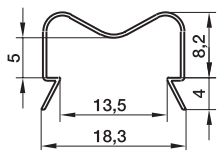
KC-195



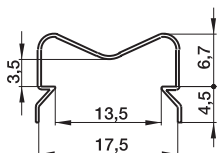
KC-199



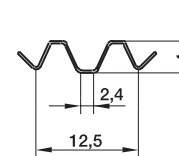
KC-196



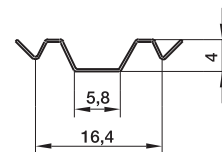
KC-196/TO-220



KC-196/SOT-32



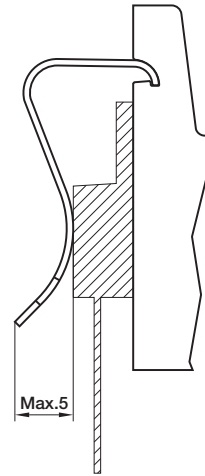
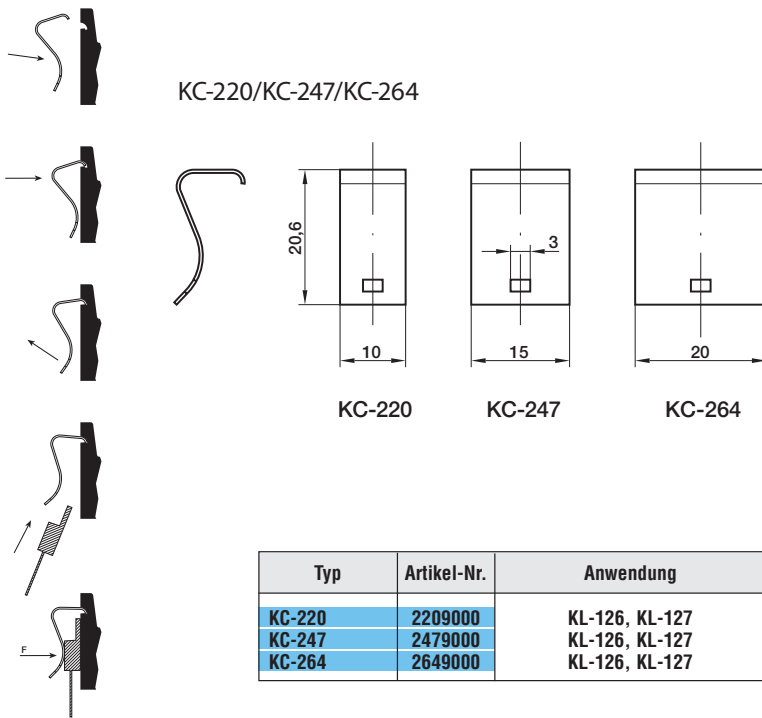
KC-205



KC-225

Typ	Artikel-Nr.	Anwendung
KC-194	1949000	KL-194, KL-197
KC-195	1959000	KL-195, KL-198
KC-196	1969020	KL-196
KC-196/SOT-32	1969010	KL-196
KC-196/TO-220	1969010	KL-196
KC-199	1999000	TO-220 (t=1-2 mm)
KC-205	2059000	KL-198, KL-205, KL-207, KL-224
KC-225	2259000	KL-195, KL-225





Die rationelle Cliplösung für viele Halbleiter-Gehäusebauformen.

Schnell Der Clipvorgang ermöglicht eine bis zu 5 mal schnellere Montage als mit herkömmlicher Technik. Weiterer Vorteil: Die Bauteile können jederzeit auch schnell demontiert oder gewechselt werden.

- Lieferbar in drei Clip-Breiten für TO-220, TO-247, TO-264, etc.
- Clipnuten natürlich auch für kundenspezifische Profile.

Sicher Durch die auf die Mitte des Halbleiters wirkende Clip-Kraft werden Biege- und Scherwirkungen, die einen Verzug und damit die Ablösung der Halbleiterkomponenten von der Basis hervorrufen, vermieden.

Kostengünstig Die Herstellung von Bohrungen oder Gewinden entfällt, der Clip ersetzt Montage-material wie Schrauben, Muttern, Feder- ringe, Isolierbuchsen, etc.

The efficient clip-on solution for many semiconductor housing designs.

Quick The clip-on method makes it possible to mount components five times as fast as with traditional mounting processes. Further benefits: The components can also be quickly removed or replaced whenever desired.

- The clips come in three different widths for TO-220, TO-247, TO-264 etc.
- Clip grooves of course also available for client-specific profiles.

Safe Due to the clip force acting on the center of the semiconductor bending and shearing effects are avoided that might cause warping and thus detach the semiconductor components from the substrate.

Costefficient There is no need for drilling or tapping threads, the clip makes redundant attachment items such as bolts, nuts, circlips, insulating bushes and the like.

L'agrafage rationnel pour de nombreuses formes de boîtier pour semi-conducteurs.

Rapide L'agrafage par clip permet un montage qui est 5 fois plus rapide que les techniques traditionnelles. Un autre avantage: les composants peuvent être démontés ou remplacés rapidement à tout moment.

- Disponible en trois largeurs d'agrafe pour TO-220, TO-247, TO-264, etc.
- Rainures d'agrafage également possibles pour les profilés spécifiques du client.

Sûr La force de l'agrafe agissant au milieu du semi-conducteur permet d'éviter les effets de pliage et de cisaillement qui provoquent une déformation et qui font par la suite que les composants du semi-conducteur se détachent de la base.

Bon marché La réalisation de perçages et de filetages n'est plus nécessaire, l'agrafe remplace le matériel de montage tel que vis, écrous, rondelles élastiques, douilles isolantes etc.